

特長 Feature

- 全層にガラスクロスを使用し、薄型と高信頼性を両立
- 実績あるビルドアップ工法を採用し、高信頼性を確保

- Realizing both thinness and high reliability using glass cross on every layer
- Secure high reliability adopting build-up method with actual result

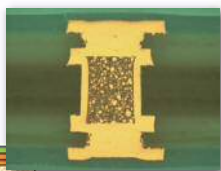
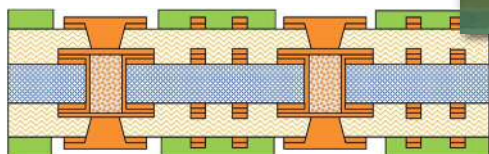
用途 Application

- 各種モジュール
カメラモジュール、GPSモジュール、Wi-Fi®モジュール、Bluetooth®モジュールなど

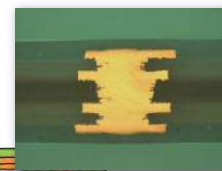
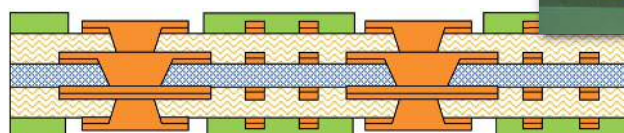
- Any kinds of modules
Camera module, GPS module, Wi-Fi module, Bluetooth module etc.

構造 Structure

- 4層 1-2-1 4L 1-2-1
- ピアスタック (BHタイプ) 構造
Via stack (BH type) structure



- エニーレイヤー構造
Any Layer structure

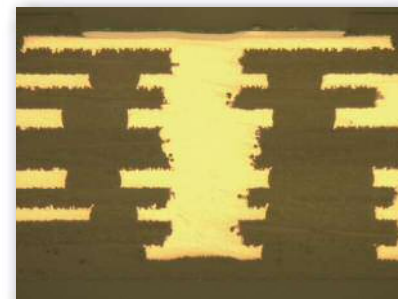
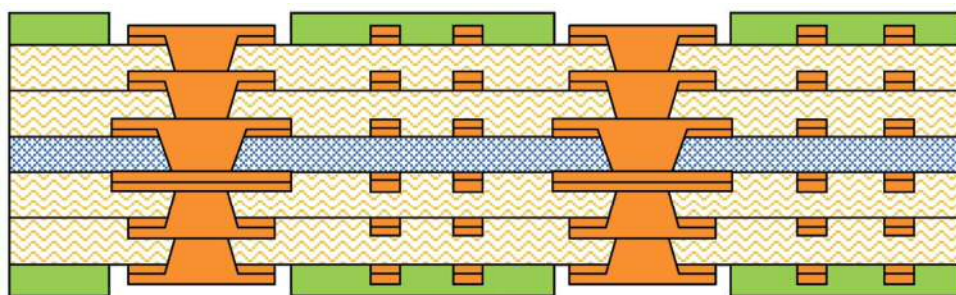


仕様 Specification

Structure	Thickness	L/S (Min.)	Via Dia./Land Dia.	
			Build-up layer	Core layer
Via stack	280μm	50/50μm	100/200μm	120/230μm
Any Layer	220μm	40/40μm	65/150μm	120/220μm

- 6層 2-2-2 6L 2-2-2

- エニーレイヤー構造 Any Layer structure



仕様 Specification

	Layer Number	Thickness	L/S (Min.)	Via Dia./Land Dia.	
				Build-up layer	Core Layer
Any Layer	6	300μm	40/40μm	65/150μm	120/220μm
R&D Any Layer	6	280μm	40/40μm	60/140μm	90/170μm

